
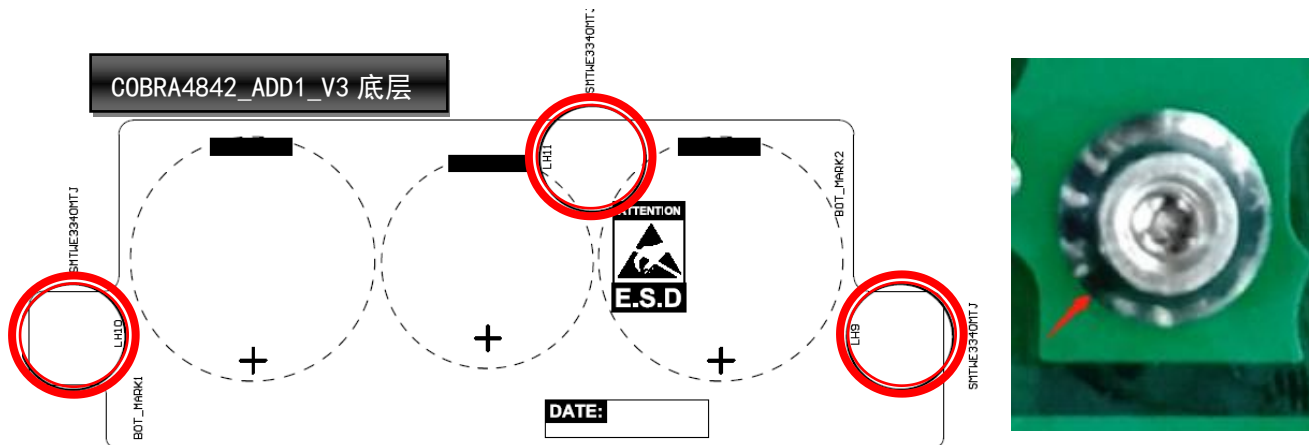



PCB 焊接工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	COBRA4842_ADD1_V3	焊接	QM0332021102503	V3	1/1	20211025

1) 贴片螺母焊接要求:

- a) LH9~LH11 位置焊接 SMTWE3340MTJ (M3*4 不带螺纹支撑柱) 
- b) 贴片螺母要求落到底焊接, 保证焊接后螺母垂直于 PCB;
- c) 贴片螺母的焊盘圆周上的过孔注满锡, 焊锡与圆柱体形成锥面 (见下图);
- d) 贴片螺母的顶端不能有沾锡

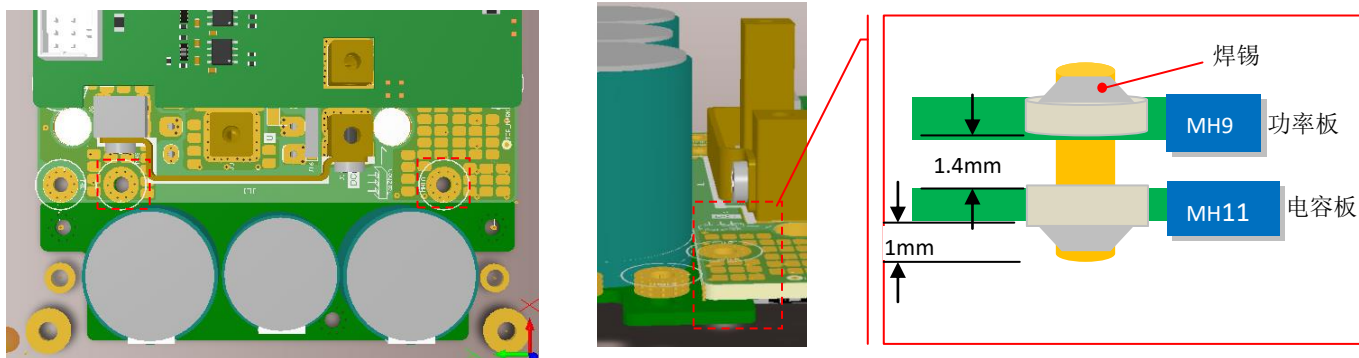


2) 电容板上的 MH11 及 MH12 分别与功率板的 MH9 及 MH10 的孔重叠 (两块板间 1.4mm 落差), 在下图  标识位置焊接两根板间电气连接的铜导线, 具体操作如下:

- a) 需要准备两根 7mm 长六平方单股铜线 (去掉绝缘层);
- b) 首先固定电容板于带 3 个定位销的铝底板【注:该铝底板仅是用于焊接铜线的治具】, 在电容板下面塞入 3mm 厚垫板, 把两根单股铜线插件到电容板上的 MH11 及 MH12 焊接孔, 完全浸润焊接, 脚留 1mm 长;
- c) 分别组装电容板及功率板于铝底板上, 将穿过功率板 MH9 及 MH10 单股铜线与功率板焊接孔在一起;

注: 在电容板下面塞入 3mm 厚垫板目的:

- 用于控制铜线焊接后, 电容板的铜线管脚高出 PCB 底板面 1mm;
- 防止焊接功率板铜线时, 高温传导到已焊接在电容板上的焊锡熔化, 铜线因重力而垂直下滑;



- 3) 所有极性元件, 严禁方向反;
- 4) 不接受虚焊, 空焊, 焊锡短路;
- 5) 未特殊说明的元件, 均紧贴线路板焊接;
- 6) 手工操作要做防静电处理;
- 7) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;
- 8) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	